

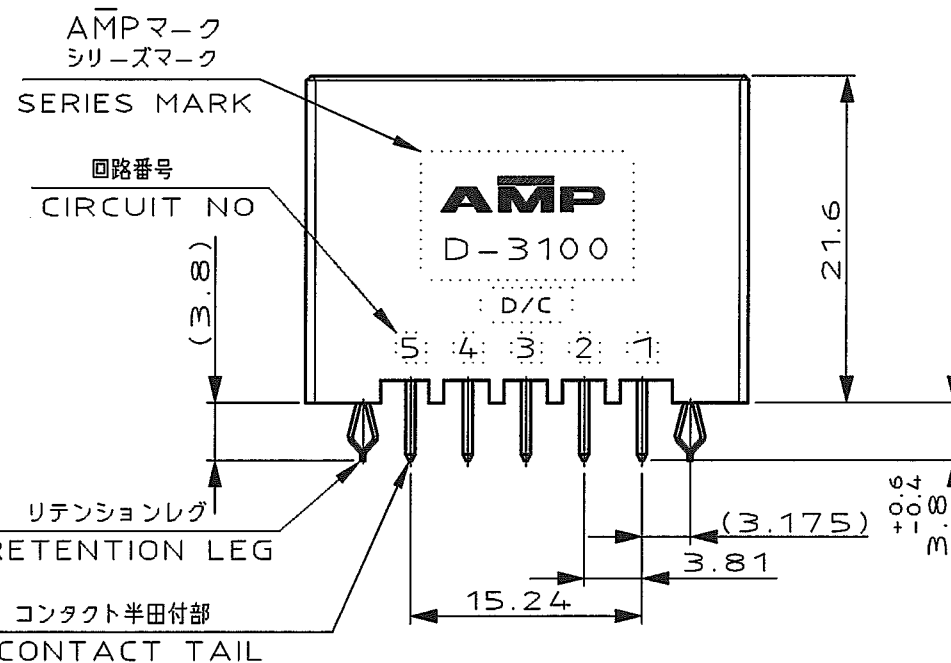
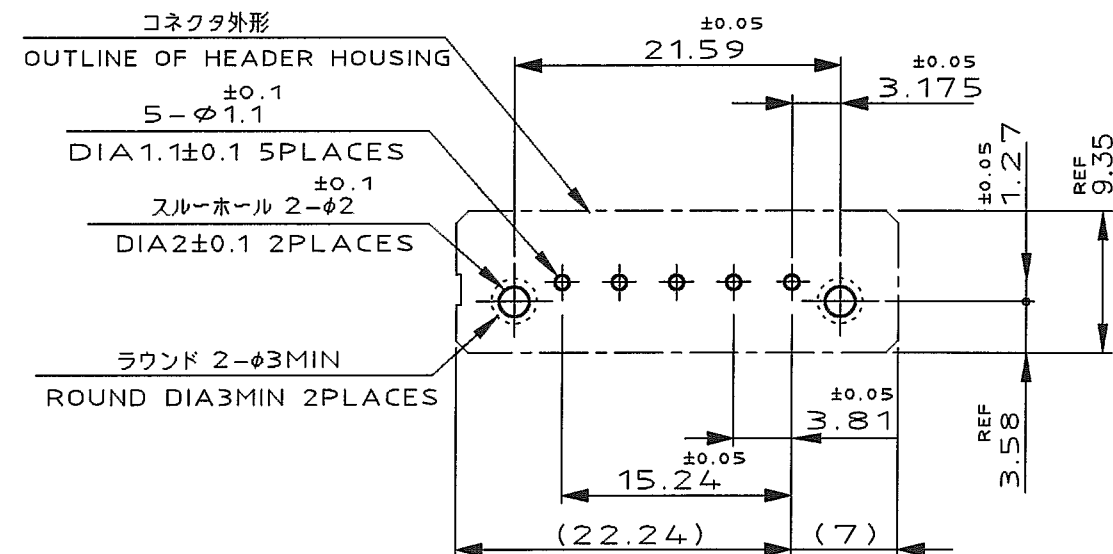
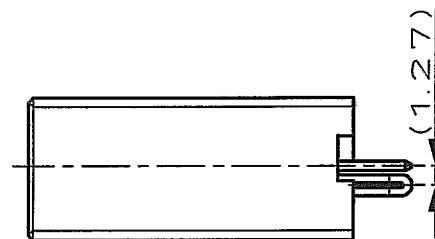
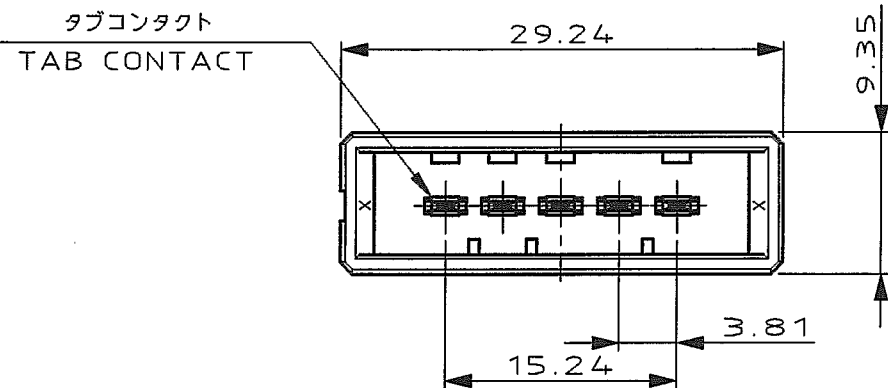
NUMBER 178315



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



推奨基板取付け寸法

PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0μm MIN スズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上にスズめっき

6	4	1-178315-5
6	3	1-178315-3
6	2	1-178315-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

E1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	23MAR11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME	
mm (AWG)		mm		5 POS SINGLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3100	
MATERIAL SEE NOTE 注記参照		FINISH SEE NOTE 注記参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
DR. 19 APR 94 N. Matsubara		DE. 19 APR 94 N. Matsubara		108F ±0.3	
CHK. 20 APR 94 S. MANABE		APP. 20 APR 94 S. MANABE		108F 304F ±0.4	
				304F 1008F ±0.45	
				角 度 ±3°	
				SIZE	LOC
				A3	J
				NUMBER C=178315	
				SCALE	REV.
				2-1	E1
				SHEET 1 OF 1	